

# 第十八届全国化合物半导体材料、微波器件和光电器件学术会议

## 征文通知（第一轮）

由中国电子学会半导体与集成技术分会、电子材料分会主办，中国科学院半导体研究所等单位承办的“第十八届全国化合物半导体材料、微波器件和光电器件学术会议”定于2016年10月下旬在福建省厦门市召开。这是每两年举行一次的全国性重大学术会议，将展示化合物半导体，特别是近年来迅猛发展的宽禁带化合物半导体在材料生长、器件与电路设计、制造工艺及其应用等方面的最新进展，探讨国内外化合物半导体、微波器件和光电器件的研究现状和发展趋势。召开这次会议的目的是为全国在本领域或有意在本领域从事研发、教学、生产、投资的科技人员和管理人员提供一个学术与技术交流的平台，以促进我国本领域的科技创新和产业发展。我们热忱欢迎本领域广大专家学者和科技人员以及相关设备、仪器制造领域的研发人员和相关企业界人士踊跃投稿、参会、参展。

主办单位：中国电子学会半导体与集成技术分会、电子材料分会

承办单位：中国科学院半导体研究所、中国电科55所、中国科学院微电子研究所、中国电科13所专用集成电路国家级重点实验室、厦门大学

会议时间：2016年10月下旬

会议地点：厦门市

重要的时间点：

1. 第二轮通知日期：2016年6月底
2. 投稿截止日期：2016年7月15日
3. 论文接收通知日期：2016年9月上旬

### 一、征文内容：

1. GaAs、InP等化合物半导体材料、微波器件及光电器件；
2. 宽禁带化合物半导体(GaN、SiC、ZnO和金刚石等)材料的制备、性质及器件应用；



3. 硅基异质结构材料(如 GeSi/Si、GaN/Si 等)制备、器件及其光电集成技术;
4. 纳米(低维)半导体材料、性质及量子器件;
5. 磁性半导体材料的制备、性质及器件应用;
6. 化合物半导体微波器件和微波集成电路的设计、制造与测试;
7. 化合物半导体光电器件和光电集成电路的设计、制造与测试;
8. 化合物半导体微波器件及光电器件制造的其它相关技术, 如耦合、封装等;
9. 化合物半导体微波器件和光电器件的可靠性与失效分析;
10. 化合物半导体微波器件和光电器件及系统的应用;
11. 新型化合物半导体材料制备、性质及器件应用;
12. 化合物半导体材料的微结构、表面、界面行为以及生长动力学研究;
13. 化合物半导体和薄膜材料的先进生长设备和测试分析仪器的研制;
14. 化合物半导体材料制备和器件研制相关的基础材料(如金属有机源、高纯金属源、高纯工艺气体等);
15. 化合物半导体和薄膜材料的表征和测试分析技术;
16. 半导体白光照明材料、器件及应用技术;
17. 其它(如稀土、有机半导体等)半导体材料、性质及器件应用;
18. 化合物半导体敏感材料、制备、表征及应用;
19. 化合物半导体微、纳电子及光电子器件制造、表征及应用;
20. 半导体光电转换材料与器件应用;
21. 集成电路设计;
22. 电介质物理与器件;
23. 其它化合物半导体相关领域最新进展等。

## 二、 投稿分类:

根据以上征文内容, 将参会者的稿件拟分为以下四大类。

1. 材料生长及表征 (Material Growth and Characterization), 类别代码: MGC
2. 高频、高功率电子器件 (Electron Devices), 类别代码: ED
3. 发光器件及光电探测器件 (Optoelectronic Devices, 类别代码: OED
4. 设备、系统及应用 (Equipment, System and Applications, 类别代码: ESA

投稿时，请参会者务必在文章的首页及 Email 的标题中提供文章类别代码（在会议提供的文章模版里将有代码位置输入提示），以便会务人员安排专家审稿。以上分类方式可能会由于届时参会人员的分布相对变化而作相应调整。

### 三、 论文要求：

1. 论文要力求反映国内外最新研究方向和成果，要主题突出，内容层次分明，数据准确，论述严谨，结论明确，采用法定计量单位，且尚未在国内外公开刊物或其它学术会议上发表过。
2. 本次会议征集到的优秀稿件将推荐到《半导体学报》发表。会议将评选出 10 篇左右的优秀论文，由中国电子学会半导体与集成技术分会颁发优秀论文证书，并给予奖励。
3. 论文一律采用 A4 纸排版，具体格式为：题目用 3 号黑体字，作者用 4 号字，单位、邮编、电子信箱、摘要、关键词等用 6 号字，正文用 5 号字，正文行距为单倍行距。字体除题目外统一用宋体，版芯尺寸为 140 mm×215 mm，包括图表在内每篇论文不超过 4 页。论文格式模版见附件 1。

### 四、 论文的提交：

请参会者提供电子版论文 PDF 和 WORD（要求可编辑）两种格式的文档。文件名称格式如下：类别代码加作者姓名，例如，MGC-姜丽娟。请将以上两种格式的文件同时发送到以下（见联系人）两个电子邮箱。并在 Email 正文中提供以下信息，以便减少会务组工作失误并减轻会务组织人员的统计工作量。

a) 文章类别代码[共 4 类]； b) 文章题目； c) 作者姓名； d) 工作单位； e) Email 地址； f) 电话

请自留底稿，不论录用与否原稿一律不退。

### 五、 会议网址

为了便于信息沟通，本次会议组委会建立了会议网页，随时发布与会议有关的最新信息，欢迎光临访问浏览。会议网址为：[cs-cie2016.csp.escience.cn](http://cs-cie2016.csp.escience.cn)

六、联系人：姜丽娟，王琨，王晓亮

电话：010-82304140

手机：13810828717

Email:ljjiang@semi.ac.cn

kwang@semi.ac.cn

### 七、参会回执

为了更好的开展筹备工作，请参会人员配合我们填写参会回执（附件2），在2016年7月15日前寄至会议筹备组。大会筹备组热忱欢迎您的到来；同时也真诚希望得到您的大力支持与帮助。

“第十八届全国化合物半导体材料、微波器件和光电器件学术会议”会议组委会

2016年3月25日

